

【Webセミナー（無料・日本語）のご案内】 [2021年3月22日開催]

～高速デジタル伝送基板、デバイス評価におけるディエンベディング手法について～

このたび、合同会社マイアテクノロジー社、AtaiTec社、アンリツ株式会社様と共催で、高速伝送基板、デバイス評価におけるディエンベディング手法についてのWebセミナーを開催いたします。

今回のセミナーでは、長年、高周波・高速デジタル伝送設計評価ソフトウェアに携わり、高精度ディエンベディングツール In Situ De-embedding (ISD) の生みの親でもある、AtaiTec社 Dr. Huang にもご参加頂きます。

セミナーは日本語で行いますが、AtaiTec社 Dr. Huang へのご質問は通訳をさせて頂きます。

■開催概要

開催日時：2021年3月22日（月）14：00～15：00（開場 13:30）

形式： Web 配信形式

対象： Gbps 高速伝送基板、デバイスの評価にご興味のある方
マイクロ波・ミリ波の回路、デバイスの評価にご興味のある方

参加費： 無料・事前登録制

■講演内容

合同会社マイアテクノロジー社 中谷より

1. イントロダクション
2. ディエンベディングの重要性
3. AtaiTec社ソフトウェアのご紹介
 - 高精度ディエンベディングツール In Situ De-embedding (ISD)
 - Sパラメータ評価解析支援ツール Advanced SI Design Kit (ADK)
4. ディエンベディング デモ
5. 高周波ベクトルネットワークアナライザのご紹介（アンリツ株式会社様）
6. Q&A（AtaiTec社取締役社長 Dr. Huang）※通訳あり

※当日、発表の順番が入れ替わる場合があります。

※受講のお申し込みをされた方には先着順でAtaiTec社ソフトウェアの評価ライセンスをご提供させて頂きます。

■お申し込み方法

メールタイトルに、“WEBセミナー参加希望”とご記載の上、

ご氏名、ご所属先、メールアドレスを以下のアドレスまでご連絡下さい。

ビフレストック株式会社 担当：太田 k-ota@bifrostec.co.jp